

出展要項

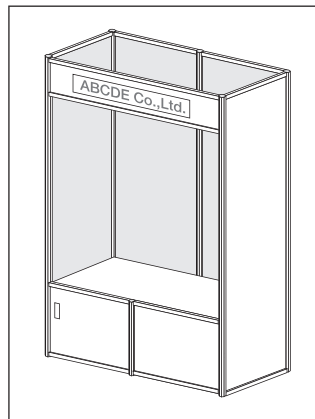
出展料	ETWest 2017 / IoT Technology West 2017
Aブース (パッケージブース)	2m×2m=約4㎡ 270,000円 [税込]
Bブース (スペース渡し) ※4小間から申込可能	2m×2m=約4㎡ 162,000円 [税込]

※Bブースは、スペース渡しとなります。但し、4小間以上から申込み可能となります。
※変則形状(四辺形以外)は原則としてお受けできません。
※4小間以上は原則複数小間になります。単列をご希望の場合は、事務局までご相談ください。

<Bブース申込の場合> パッケージブース、レンタル備品のご案内
事務局では、出展社の皆様の出展サポートとして、低コストのパッケージブースプラン及び、各展示用レンタル備品をご用意しております。
皆様の出展のご検討とあわせまして、出展費用のご参考としてご確認ください。
詳細は4月(予定)に行われる出展説明会にてご説明させていただきます。

小間仕様

Aブース 1小間仕様
・バックパネル
・システムカウンター
…………… (W1950×D950×H750)
・パラペット …………… (W1950×H300)
・社名板 …………… 一式
・蛍光灯 …………… 1灯
※展示台には片方に引き戸が付いています。
※コンセント(電気使用料500Wまで)をご希望の場合は別途無料にて承ります。(要申請)



申込期限 **2017年2月28日(火) 必着** ※ただし、満小間になり次第締め切らせていただきます。

申込について
■出展規約：出展申込にあたっては、別紙出展規約を遵守することを承諾した上で出展申込書を事務局宛に送付してください。
■出展社説明会：2017年4月の開催予定です。
○説明会概要
出展要項及び出展サポートプログラムの詳細についての説明、会場仕様と小間割りの説明などを行います。※詳細につきましては後日ご案内いたします。
■共同出展について：複数の企業が同一ブースに出展する共同出展が可能です。ただし、社数は小間数と同数以下に限らせていただきます。共同出展社がある場合は、指定された書式で申請し、事務局の承認を得てください。事務局が承認した共同出展社は公式ホームページ等で紹介されます。

出展社セミナー

西日本の企業へのPRにご活用下さい!

出展社セミナーは展示会出展とともに、西日本の企業に向けた自社製品・ソリューションの紹介や、有望顧客の囲い込み、聴講者のブース誘導といった会期中の営業・PR活動の成果をあげるためにご活用いただけます。

【会場】展示会場に隣接したセミナールーム(100席※予定)

1枠/45分	108,000円 [税込]
--------	----------------------

※セミナーご利用はA/Bブースいずれかをお申込いただいた出展社に限ります。
※セミナールームは、スクール形式100席(予定)、スクリーン、マイク、プロジェクター、演台が常設されております。
※出展社セミナーのほか、多数の出展サポートプログラム(有料)をご用意しております。詳細は事務局までお問合せください。



開催までのスケジュール

2016年 9月	2017年 2月	3月	4月	5月	6月	7月
先行予約 申込締切日 9月30日(金)	出展申込 締切日 2月28日(火)		出展社説明会 4月下旬	来場案内 配布 5月下旬	各種提出書類 締切 6月中旬	搬入・設営日 7月11日(火) 展示会開催 7月12日(水)・13日(木)

お申し込み
お問い合わせ

Embedded Technology 事務局/ IoT Technology事務局
TEL:03-5657-0756 FAX:03-5657-0645 e-mail: etinfo@jasa.or.jp

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 株式会社JTBコミュニケーションデザイン内

ETWest / IoT Technology West公式サイト <http://www.jasa.or.jp/etwest/>

組込み技術×IoT技術の総合展&カンファレンス



組込み総合技術展 関西

Embedded Technology WEST 2017



IoT総合技術展 関西 Internet of Things Technology

IoT Technology WEST 2017

主催：一般社団法人組込みシステム技術協会 / 企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン内

会期 **2017年7月12日水・13日木**
会場 **グランフロント大阪
コングレコンベンションセンター**



最新技術が集結する
《組込み×IoT》総合技術展
大阪中心部のグランフロント大阪で開催!



ETWest / IoT Technology West公式サイト

ETWest IoT

検索



一般社団法人
組込みシステム技術協会
Japan Embedded Systems Technology Association

Jtb Communication Design

開催概要

名称: **Embedded Technology West 2017／組込み総合技術展 関西**
IoT Technology West 2017／IoT総合技術展 関西

主催: 一般社団法人 組込みシステム技術協会
 企画・推進: 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

会期: 2017年7月12日(水)・13日(木) 10:00~17:00 会場: グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター

前回開催実績

※同時開催展
 「Smart Energy Japan 2016 in Osaka」含む

出展社数:

119
社・団体

小間数:

184
小間

来場者数:

6,715
名

西日本からの来場:

90%
※2015年来場実績

来場企業・団体数:

1,992社
※2016年来場実績

■ 西日本を拠点とする主要企業への販促の絶好の機会です!

展示会場

ETWest エリア



目的意識の高い技術者、
 マネジメント層が
 中核の来場者です!

IoT Technology West
 エリア



カンファレンス

◎基調講演

展示会コンセプト・テーマに産業界のトップ企業や官学の各分野からキーパーソンを招聘し、組込み業界として注目される旬のテーマに沿った将来展望を語ります。

◎テクニカルセッション

現場の第一線で活躍するトップレベルの技術者や専門家が、いま学んでおきたい技術テーマをじっくりレクチャーする技術セミナーです。

◎ヒートアップセッション

組込みシステム開発にまつわる技術課題、ビジネスビジョンなど、いま知っておきたいホットなテーマを取り上げ、聴講者とともに掘り下げていくセッションです。

カンファレンス受講者数:

2015年
40
 セッション
4,556名

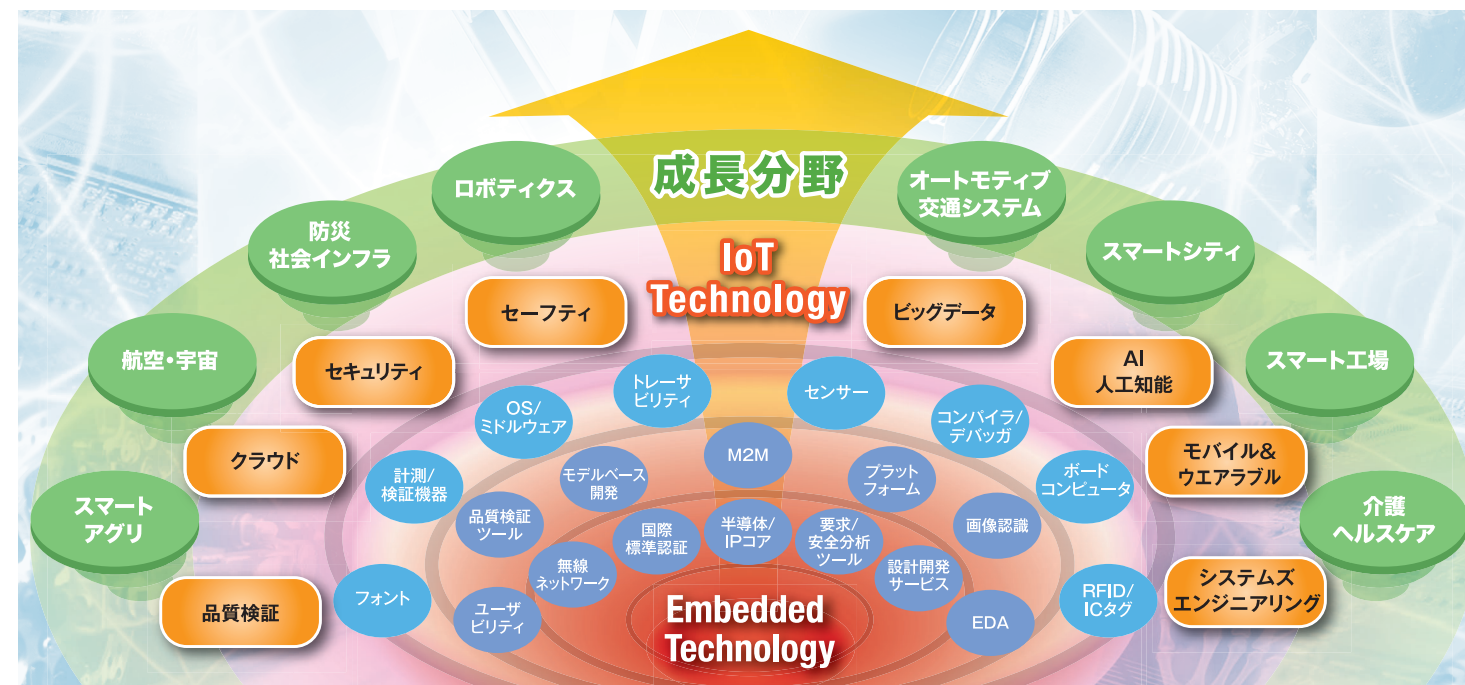
2016年
39
 セッション
4,991名



前回は対前年比
 約**110%**の
 聴講者を集客!

最新の技術動向をはじめ、多彩なテーマの
 無料カンファレンスを併設することで、
 幅広い分野の来場者を集客します。

ETWest / IoT Technology West コンセプト図



ETWest 出展対象と来場対象

出展社

ハードウェア・ソリューション

CPU/MCU、DSP、映像・画像処理技術、SoC、ASSP/ASIC、メモリモジュール、SSD、IPコア、FPGA/PLD、メディアプロセッサ、アナログIC(電源用、A/D、D/A等)、パワー半導体、有線/無線ネットワーク(WiFi、Bluetooth、ZigBee等)、通信インタフェース(HDMI、USB等)、NFC、RFID/ICタグ、MEMS、ラック/ソケット、ROM/Flashプログラミング装置、組込みプラットフォーム、ボードコンピュータ、産業用PC、タッチパネル・ディスプレイ、その他

開発環境・ツール

開発支援ツール、言語系(C/C++、Java、HTML/XML、UML、SysML、コンパイラ/アセンブラ等)、デバッグツール(ICE、エミュレータ、デバッガ、シミュレータ等)、統合開発環境、計測機器(オシロスコープ、アナライザ、分析機器、信号発生器等)、LSI設計/検証ツール、システム設計ツール、プリント基板設計ツール、Co-Designツール、コペリフィケーションツール、品質管理ツール、テスト・検証サービス、EDAツール、その他

ソフトウェア・ソリューション

リアルタイムOS、組込みLinux、Android、デバイスドライバ、ファームウェア、ミドルウェア、コーデック、組込みフォント、組込みデータベース、セキュリティ関連(アンチウイルス、暗号、認証等)、ユーザビリティ関連ソリューション、その他 ソフトウェアIP、ソフトウェア部品

インテグレーション/デザインサービス/関連企業・団体

受託開発/コンサルティング、品質検証サービス、ROM/Flashプログラミングサービス、大学/研究機関、地方自治体/地域活動団体、標準化・技術普及団体、出版、教育/人材育成、人材派遣、その他

来場者

- 自社製品・ソリューション開発のため組込み製品を導入する幅広い分野のメーカー(技術者・マネジメント層)
 ※分野例: オートモティブ、スマートエネルギー、医療/介護、社会インフラ、FA、通信/モバイル/ネットワーク など
- 機器・システムの設計や開発パートナーをお探しの組込み開発・設計を行う技術者
- 企業ニーズに合わせた製品・ソリューションを探すシステムインテグレーター

IoT Technology West 出展対象と来場対象

出展社

- IoT向け半導体デバイス
- ◎各種センサーネットワーク/M2M技術
- ◎遠隔監視・制御システム
- ◎ワイヤレスネットワーク(Wi-SUN、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、NFCなど)
- ◎ウェアラブル関連機器
- ◎ITS関連システム(車載ネットワーク、交通管理システムなど)
- ◎データ分析・解析技術
- ◎IoT向けプラットフォーム設計技術
- ◎セキュリティ/認証技術
- ◎スマートエネルギー関連技術(ワイヤレス電力伝送、スマートメーターなど)
- ◎IoT向けインテグレーションサービス
- ◎各種認証取得サービス(無線認証など)

来場者

- IoTシステムの企画、構築、運用などの業務を一括して請け負うソリューションベンダ
- IoT活用に向けたアプリケーション開発を行う技術者
- 多様な産業分野でサービス提供を図るメーカー、サプライヤの技術者・マネジメント層

ET/IoT Technology 事務局 行

FAX:03-5657-0645

■申込締切 **2017年2月28日[火]**

●送付先
Embedded Technology / IoT Technology 事務局
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング
(株) JTBコミュニケーションデザイン内
Tel: 03-5657-0756 Fax: 03-5657-0645
E-mail: etinfo@jasa.or.jp

裏面の出展規約を遵守することに同意し、下記のとおり出展を申し込みます。

<個人情報の取扱いについて> 個人情報取り扱いについて、下記URLをご確認の上、同意くださいますようお願いいたします。
主催：一般社団法人組込みシステム技術協会 / 企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
【個人情報取り扱いについて URL：http://www.jasa.or.jp/expo/others/privacy.html】

申込年月日	年 月 日	☐ 上記の<個人情報の取扱いについて>に同意します。	
申込展示会	☐ Embedded Technology West 2017 ☐ IoT Technology West 2017		
出展社名(和文)	フリガナ ※記入頂きました出展社名は来場案内等に掲載させていただきますので、出展社名は必ずご記入下さい。		
出展社名(英文)			
会社名(和文)	フリガナ -----		
所在地(ビル名まで)	〒 ----- TEL: ----- FAX: ----- 貴社のURL http:// ----- 公式サイトからのリンクを希望しない場合はチェックしてください。 ☐ 希望しない		
連絡担当者	フリガナ 所属 氏名 ☐ 印 役職 E-mail: -----		
出展申込内容/料金	☐ Aブース(パッケージブース付) ※1~3小間まで 270,000 円(税込) × 小間 = 円 ☐ Bブース(スペース渡し) ※4小間より 162,000 円(税込) × 小間 = 円		
出展社セミナー	☐ 出展社セミナーを申し込みます。 108,000 円(税込) × 枠 = 円 ※A/Bブースいずれかにてお申込みいただいた企業限定となります。また、お申込みは先着順となります。		
出展物	◎できるだけ詳細に		

代理店用記入欄	<出展申込み及び各種手続きを上記出展社の代理で行う会社がある場合、以下の各欄にご記入ください。>		
代理店名	フリガナ -----		
所在地(ビル名まで)	〒 ----- TEL: ----- FAX: -----		
担当者	フリガナ 所属 氏名 役職 E-mail: -----		
連絡先指定 該当する方に チェックしてください	① 請求書: 宛名(☐ 代理店名 ☐ 出展社名) / 送付先(☐ 代理店 ☐ 出展社) ② 事務局からの各種ご案内: (☐ 代理店 ☐ 出展社 ☐ 両方) ③ その他ご要望がございましたらご記入ください : ()		

備考	
----	--

--	--	--

事務局記入欄

Embedded Technology / IoT Technology 出展規約

1. 出展申込みと契約の成立

出展希望社は、本出展規約を遵守することを承諾した上で、出展申込書をET/IoT Technology事務局宛に送付してください。本出展の契約は、出展申込書を事務局がFaxまたは郵送にて受理した時点をもって成立するものとします。
尚、出展申込書が受理された企業/団体を出展社といたします。

2. 出展料の支払い

出展申込書を受理後、請求書を送付いたしますので記載されている支払期限までに、出展料の支払いを完了するものとします。指定された期日までに出展料の入金を確認されない場合は、出展契約を取り消すことがあります。
原則、支払期限は会期前までといたします。やむを得ず会期後の支払いとなる場合は、主催者に書面に支払日を通知し、承認を得るものとします。
出展社からの支払いは、請求書に記載の指定口座に日本円で支払うものとします。
約束手形・小切手等の取扱いはいたしません。

3. 出展申込の変更・取消し

出展申込後の変更・取消は原則として認められません。
但し、主催者にてやむを得ないと判断した場合は変更・取消しを認め、次の基準で取消料を申し受けます。

書面による取消し通知を受領した日を基準とする	取消料
2017年2月28日(火)以前	出展料の50%
2017年3月1日(水)以降	出展料の100%

4. 小間の転貸などの禁止

出展社は、自社分の小間を主催者の承諾なしに転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできないものとします。

5. 共同出展社の取扱い

複数の企業/団体が同一ブースに出展する共同出展が可能です。共同出展がある場合は、指定された書式で申請し、事務局の承認を得てください。ただし、出展社を含む企業/団体の数は小間数と同数以下に限らせていただきます。

6. 小間の割当

出展社の小間位置は、出展内容、会場仕様等を勘案し、主催者が決定いたします。小間割り発表後も主催者が必要と判断した場合、小間割りを変更することがあります。なお、小間位置の不服を理由とする出展の取消はできません。

7. 出展物の設置及び撤去

出展社は、主催者の定める規定に沿って小間内の装飾、及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。

8. 主催者による出展の取消し

- (1) 主催者は、出展申込書を受領後であっても、当該出展社がEmbedded Technology/IoT Technologyにふさわしくないと判断した(人、物、行為、印刷物、および主催者が問題あると考える性質の全てにおよぶもの)場合、既に払い込まれた出展料を返還することを条件に、出展社に出展の辞退を求めることができるものとします。
- (2) 主催者は、指定された支払い期限までに、出展料を支払わない出展社については、その出展の決定を取り消すことができるものとします。

9. 展示場の使用

宣伝・営業活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。
各出展社は、宣伝活動のために小間近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。
装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を越えてはならないものとします。主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。
上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展社に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。

10. 出展物の管理と免責

主催者は、展示会場の管理・保全について事故防止に最善の注意を払いますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。

11. 保証条項

出展社は主催者に対し、展示会の出品またはこれに関連する出品品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとします。

12. 出展社の義務

- (1) 出展社は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、すみやかにその責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。
- (2) 共同出展社が第三者からの知的財産権侵害のクレームを受けた場合も、出展社が前項と同様の義務を負うものとします。

13. 損害賠償

- (1) 出展社は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備または展示会の建造物、出展物、もしくは人身等に対する一切の損失についての責任を負うものとします。
- (2) 出展社は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務(弁護士報酬を含む)、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。
 - ① 出展社の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展社とともに被告とされた場合を含む)。
 - ② ①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合(和解について、主催者は出展社の意思に拘束されないものとします)。

14. 展示会の中止・中断

- (1) Embedded Technology/IoT Technology(またはその一部)が不可抗力事由により、開催または継続が不能または困難であると主催者が判断した場合、主催者は開催の中止または中断をすることができるものとします。
出展社は、いかなる場合でもその決定により蒙った損害の損害賠償を主催者に対して請求することはできません。
- (2) 前項の不可抗力事由とは、台風・洪水・風害・地震などの天災および疫病・火災・その他の事故、国および地方公共団体等の法的規制決定がある場合をいいます。

15. 招聘保証

主催者はいかなる理由があっても、日本国外務省が定める書式の招聘保証書・招聘理由書を出展社に対して発行しないものとします。

16. 査証の取得

海外の出展社が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展社の責任において作成、手続きを行うものとします。
この書類作成について、主催者は、「出展確定通知」のみの書類を発行いたします。また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展社が出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責任を負いません。

17. 規定の遵守

出展社は、主催者が定める一連の規定を本規約の一部としこれを遵守することに同意するものとします。

18. 規約の変更と追加

出展社は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。
主催者は、出展社に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有するものとします。

19. 準拠法

本契約の準拠法は日本法とします。

20. 合意管轄裁判所

本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。